

Dickschichtmetallisierung: AgPd oder AgPt

Substratmaterial	ANCeram Aluminiumnitrid
Oberfläche	$R_a < 1.0 \mu\text{m}$
Schichtdicke	14 μm (typ.), 10 μm (min.)
Metallisierung	AgPd – oder AgPt-Paste
Geometrie	nach Kundenwunsch
min. Leiterbahnbreite	150 μm
min. Leiterbahnabstand	150 μm
Flächenwiderstand	4,5 +/- 0,5 m Ω / \square
Lötempfehlung	Sn62PbAg2
Haftfestigkeit	> 20 N/mm ²

Diese Daten entsprechen unserem aktuellen Kenntnisstand. Änderungen, bedingt durch Produktverbesserungen und Weiterentwicklungen sind möglich. Kundenspezifische Anpassungen und Ausführungen sind auf Wunsch machbar. Klimatisch-mechanische Prüfungen nach DIN 41848 bzw. MIL-STD-883 C wurden durchgeführt.

Stand 03/04

